

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案 的半年度评估报告

为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的相关要求，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“普冉股份”）在对 2024 年“提质增效重回报”行动方案落实评估的基础上，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2025 年 3 月 31 日披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司“提质增效重回报”2024 年度方案执行情况及 2025 年度行动方案的报告》，报告明确了行动方案的相关细则。2025 年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，方案半年度实施情况具体评估如下：

一、完善存储主线产品及客户结构，夯实发展根基；延伸“存储+”条线，强化公司规模增速

公司自 2022 年，拓展“存储+”战略条线至今，秉承着双战略并行，多产品线协同并举，保持高强度研发投入，重视产品研发创新和工艺深化。在原有存储芯片领域，继续拓展品类，加速产品迭代及产品性能和成本优化，并加强向工控、车规等领域发展的投入，持续扩大市场份额。同时，公司发挥特色工艺优势，延展“存储+”战略路径，持续增强公司的自主研发能力，加强公司人才梯队建设，推进 MCU 和 Driver 等新产品技术与应用布局。

2025 年上半年，存储行业景气度复苏节奏较去年上半年有所放缓，同时行业处于竞争格局变化的关键窗口期，公司“攻守兼备”持续夯实存储产品线的市场份额。同时，在“存储+”领域，公司基于 M0+产品线持续扩展产品品类，挖掘新类别终端及客户，加速出货；此外，公司推出 M4 系列产品，开拓中高端市场份额，MCU“向下扎根、向上生长”，同比依然保持着较高增速。

报告期内，公司实现营业收入 9.07 亿元，同比增长 1.19%，实现扣非前净利润 0.41 亿元，较去年同期减少 1.36 亿元，实现扣非后净利润 0.27 亿元，较去年

同期减少 1.51 亿元。主要系公司规模扩大带来的营运费用增长以及研发费用增加，另外受到存货跌价准备的影响。公司持续在产品、市场、供应链等多维度协同发力，积极应对市场挑战，扩张市场份额，保持高强度研发确保产品完备性及技术领先性，谋求稳健发展与持续突破。

1、巩固存储基石，持续优化产品制程及性能，积极拓展客户类别

报告期内，公司实现存储系列芯片营收 6.73 亿元，毛利率 31.82%。出货量同比有所下降，主要系 2025 年上半年消费景气度回落带来的终端出货节奏放缓。存储作为公司产品矩阵的基石，处于重要的战略地位，报告期内产品线具体进展如下：

(1) NOR Flash

公司目前该产品线已实现双工艺、多制程、全容量等完善的产品矩阵。公司产品采用 SONOS（电荷俘获）及浮栅（ETOX）双工艺结构，提供了 512Kbit~1Gbit 容量系列，覆盖 1.1V~3.6V 操作电压，具备低功耗、高可靠性、快速擦写和快速读取的优异性能。报告期内：

1) 公司 SONOS 第二代 40nm 工艺制程节点下 4Mbit~128Mbit 容量系列产品已成为公司 SONOS 平台的出货主力，进一步提高了公司的成本优势，在满足容量需求的同时更好地满足下游新型应用的体积需求。

2) 公司 SONOS 工艺的第三代 40E（40nm Enhance Platform）平台 4Mbit~16Mbit 小容量系列已经顺利量产，32Mbit~64Mbit 容量系列计划于今年年底量产，该平台的技术优势将继续为公司保持较高的行业竞争力水平。

3) 公司 ETOX 工艺结构提供以中大容量为主、中小容量为辅的系列产品，目前产品线覆盖 55nm 及 50nm 制程；同时实现了 4Mbit~1Gbit 全容量系列的量产出货。

4) 公司 ETOX 工艺平台 4Xnm 64Mbit 产品已完成原型验证。同时，公司 ETOX 工艺平台 1.65V~3.6V 宽压系列已完成部分容量产品的量产；256Mbit~512Mbit 大容量产品已交付了部分工控、通讯等客户。

(2) EEPROM

公司 EEPROM 产品线目前已覆盖 2Kbit~4Mbit 容量，操作电压覆盖

1.2V~5.5V，主要采用 130nm 及 95nm 及以下的双工艺制程，其中 P24C 系列产品擦写次数可达 1000 万次、数据保持时间可达 100 年，具有高可靠性、体积小、性价比高等优势，公司已于手机摄像头、其他消费类及周边等获取了较为稳定的客户基础，且具备一定规模的市场份额，同时，持续拓展在工业控制、汽车电子、通讯等领域的市场份额。报告期内：

1)EEPROM 产品抓住运动相机、电话手表等摄像头新型需求市场，以及 1.2V 低电压产品跟随主控更新换代的机会，夯实了在摄像头市场的领导地位，同时工控领域和车载领域应用占比也持续提升，公司全系列 EEPROM 车规产品均已通过 AEC-Q100 Grade1 标准全面考核，在车身摄像头、车载中控、娱乐系统等应用领域持续推进对海内外客户的批量交付，工业控制和汽车领域的应用占比持续提升。

2) 公司大容量 EEPROM 系列产品，支持 SPI/IIC 接口产品已经批量运用于光模块、高速宽带通信、数据中心、服务器等领域。

3) 新产品线研发上，公司已经成功量产 SPD 系列产品，主要为 SPD（Serial Outline DIMM，串行存在检测）及 TS（Temperature Sensor，温度传感器）系列配套，具有高可靠性特点，能够满足相关应用场景对数据保存的较高要求，主要配套新一代 DDR5 内存条，应用于计算机和服务器领域，可存储内存条相关信息，如容量、速度、电压等，帮助计算机正确识别和配置内存，确保内存正常工作。该系列产品稳步推进客户导入，上半年已实现批量出货，后续将一定程度带动 EEPROM 产品线的增长速度。

2、“存储+”业务不断拓展，第二增长曲线带动作用显现

得益于“存储+”战略的稳步实施，MCU 产品及 Driver 等模拟类新产品不断推出，表现优异，得到市场持续认可，市场份额持续提升，带动了公司整体收入水平。2022 年出货首年至 2024 年末，公司“存储+”系列芯片出货量已提升 10 倍，2025 年上半年这一增长趋势得以延续，报告期内，公司“存储+”产品线实现营业收入 2.33 亿元，同比增长 35.62%，毛利率 28.69%，出货量同比上升，成为公司新的增长引擎，也充分验证了公司的技术创新能力和产品竞争力。报告期内，产品进展如下：

(1) MCU

公司基于领先工艺和超低功耗与高集成度自有设计的存储器优势，布局 ARM Cortex-M 内核系列 32 位通用型 MCU 产品，覆盖 55nm、40nm 工艺制程，实现了从入门级到主流 MCU 的多方位布局，主要应用于智能家居、小家电、BMS、无人机、无刷电机、逆变器、电子烟等下游领域。2022 年出货至今，总出货量超过 14 亿颗。报告期内,该产品线进展如下：

1) 公司目前已经推出 M0+和 M4 内核超过五大系列、百余款产品，产品支持 24MHz~144MHz 主频、24KByte~384KByte Flash 存储容量、USB/CAN/SDIO/Ethernet 等主流接口，以及 20~100 IO 的多种封装形式，形成宽电压、低功耗、支持-40℃~105℃及 125℃高温等高质量、高可靠性、高性价比通用产品矩阵。

2) 公司基于 ARM 内核的 M4 MCU 产品已有 11 颗料号量产出货，产品主要覆盖舞台灯光（多 PWM（脉冲宽度调制））、电机控制、智能硬件、TFT 屏幕驱动等诸多应用领域。

3) 公司开发了电机专用系列 M0+产品，与 Driver 协同出货，覆盖 40V~600V 宽电压、全系列电池范围，其中 7 个子系列已经量产出货，主要应用于以马达驱动为核心的电动工具等下游应用领域。

4) 公司基于家电主控和消费电子触控功能领域开发了相关高性能触控技术 MCU 芯片产品，支持从 20Kbyte~32Kbyte Flash 存储；集成 UART/SPI/I2C 等接口；分别支持 26 IO 和 32 IO；工作环境温度范围支持-40℃~105℃，目前已实现大规模量产。

5) 报告期内，公司持续和 Keil/IAR 深入合作，为客户提供 PY32 全系列 MCU 的开发环境和编译器支持；升级了自带仿真功能的新版 Starkit 开发板，便捷了工程师调试及客户的应用；推出了 PY Studio 图形化代码生成器软件工具，使用者可以一键生成代码；完成了 PY32 系列烧录器的开发，为客户提供高品质的烧写服务。公司通过持续扩充 MCU 研发、芯片测试、方案开发、应用支持及市场业务人员团队，大力推进 MCU 完整生态建设。

(2) Driver

公司该产品线主要应用在手机摄像头模组，协同 EEPROM 产品线，目前已

经在开环、分离式 VOIS 和一体式 OIS 上取得了持续进展。开环产品已经大规模出货，和品牌手机厂商顺利导入。同时公司结合产业发展趋势，与终端密切配合，研发的第三代 VOIS（光学防抖音圈马达驱动）芯片实现量产，防抖等级提升，提升了终端稳定性与使用效果。OIS 芯片也在手机和安防客户端批量交付。同时，儿童电话手表、运动相机等各类终端为市场带来新兴防抖需求，为公司产品打开更大的市场空间。此外，公司该产品线协同推进 MCU 预驱产品等出货，协助 MCU 电机市场份额持续拓展。

3、高研发投入赋能产品创新，专利与人才双轮驱动增长

公司高度重视研发投入，致力于通过持续创新巩固市场地位并开拓新的业务增长空间。报告期内，公司投入研发费用 1.48 亿元，占营业收入的比例达到 16.29%，较上年同期增长 3.87 个百分点。主要系公司积极扩充研发人员团队，为各类研发项目注入充足人力支持，有效的推动了公司新产品线的规划、开发和量产。公司持续完备存储产品线，以满足市场不断变化的需求，如下一代制程 NOR Flash、SPD 等新产品；同时，在“存储+”方面，公司也持续推出 MCU 及 Driver 等模拟类产品，如 M4 系列新品及新一代 Driver 产品等。不断量产的新产品是公司研发投入的重要成果体现，进一步丰富了公司的产品线，为公司未来的持续发展奠定了坚实基础。

公司研发人员达到 284 人，占公司总人数比例超过 60.17%，较上年同期增加 25.11%，其中硕士研究生及以上学历占比超过 38%，本科及以上学历占比超过 95%。高素质的研发团队为公司技术创新和产品升级提供了坚实的人才保障，进一步强化了公司在行业内的核心竞争力。

此外，公司拥有多项自主知识产权和核心技术，并形成了有规划、有策略的专利布局。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计获得 64 项发明专利，10 项实用新型专利授权；报告期内，公司取得 8 项发明专利，新提交 4 项发明专利；取得 6 项集成电路布图设计登记。公司已获授权的发明专利达 64 项，集成电路布图设计证书 61 项，已经建立起了完整的自主知识产权体系。

二、海内外市场同步驱动，品牌资本协同赋能高质量发展

1、海内外多点突破，全球化布局深入

2025 年上半年，公司延续 2024 年积极进取的市场拓展态势，围绕“巩固国内根基、加速全球布局”的战略方向，在海内外市场取得了进展与突破。国内市场，公司持续深化本地优势，各产品线协同效应持续显现。依托已经建立起的稳固的客户网络，公司 NOR Flash、EEPROM、MCU、Driver 等产品协同赋能，实现客户资源的高效共享和深度挖掘。报告期内，公司在消费电子、工控、通讯等核心领域拓展了新的客户与终端市场，同时对现有客户的合作广度和深度进行了有效延伸，推动了出货量的稳步增长。

海外市场方面，在 APEC、EAME 地区，公司与现有海外客户的合作关系更加紧密，通过差异化产品策略和高效服务体系，成功打入多个新的应用场景，市场份额较去年有所提升。欧美市场，公司重点导入工业及通讯类市场，实现了该些领域的持续突破；在日韩、印度等亚太地区，公司持续强化本地化服务能力，快速响应客户需求，有效提升了产品在当地市场及重要大客户上的综合竞争力。在中东等新兴市场，公司持续关注需求变化，积极推进渠道建设，为后续业务拓展奠定基础。

2、各类奖项加持品牌影响力，创新实力获权威认可

2025 年上半年，公司积极参加各类展会，加大品牌曝光力度，获得了多家主办方及评选单位的各类奖项，增强了公司的行业影响力：

参展 IIC2025，荣获“2025 年度技术突破 IC 设计公司”；

参加 2025 慕尼黑上海电子展，展示了各条产品线最新研发成果及解决方案；

参加浦东开发开放 35 周年举办的“2025 年浦东新区突出贡献企业答谢活动”，荣获浦东市人民政府颁发的“2024 年度浦东新区创新创业奖”；

参加由中国集成电路设计创新联盟、中国汽车芯片产业创新战略联盟等举办的第十二届汽车电子创新大会(AEIF)，荣获 2025“汽车电子·金芯奖-卓越产品奖”；

公司两款芯片产品成功入选上海市经信委发布的《2024 年度上海市创新产品推荐目录》。

3、产融结合赋能生态，战略投资蓄力长远

报告期内，公司于资本运作与产业布局层面持续发力，基于过往的基金投资及战略配售，持续拓展业务边界、优化产业生态。

公司以自有资金参投华大九天 A 股 IPO 战略配售以来，获得了可观的投资收益，同时形成了深度战略业务合作关系。同时，公司参投的季丰电子保持良好的营运表现，持续为公司提供优质服务，发挥着上下游产业链协同效应。

私募股权投资领域，公司参投的上海渠清如许创业投资合伙企业（有限合伙）以及珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）在上半年稳步推进各项工作。通过与这些专业投资机构合作，探索潜在的规模化成长路径，实现产业与资本的深度融合。

公司将继续围绕主营业务核心，秉持业务与资本协同发展理念，灵活运用资本市场工具，持续关注优质的投资机会，为公司长远的发展积蓄新的增长点，不断提升公司在行业内的综合竞争力和市场影响力。

三、精耕成本管控，筑牢供应链根基，驱动稳健优质发展

1、全流程成本管控，设计优化、成本提效、采购管控多措并举

报告期内，公司密切关注市场动态及行业周期变化，严格遵循既定的成本管控策略，从产品设计、生产制造到采购管理等全环节，持续深化成本管控工作，取得了一定的成效。在产品设计环节，公司基于 SONOS 及 ETOX 双工艺架构，在确保产品性能满足市场和客户需求的前提下，全力推进芯片制程缩进工作。通过研发团队技术攻关与设计优化，双平台的新一代制程产品均成功推出，有效降低了单位芯片的原材料消耗，提高了晶圆利用率，达到了持续降本的目标。

生产环节，公司与晶圆厂保持密切合作关系，双方协同推进工艺水平提升。上半年，公司各条产品线的良率均持续提高。采购环节，公司成立采购评审委员会，依托专业团队进行成本管控。报告期内，公司加强了与核心供应商的战略合作，凭借长期稳定的合作关系及采购模式，在关键采购价格层面积极争取有利条件，使得成本得以有效控制。此外，公司持续推进库存管理体系，通过优化升级相关 ERP 系统流程，尽可能平衡市场需求与库存调度的匹配关系，使得库存管控更为精确和高效。

2、供应链体系升级，战略合作深化，募投项目顺利推进

（1）公司与国内主要晶圆代工厂、封测厂保持紧密的战略合作关系，多维度强化公司合作的深度和广度，确保供应链产能的稳定和安全。报告期内，公司贯彻落实“QCDST”理论的供应商管理机制，从质量（Quality）、成本（Cost）、发货（Delivery）、服务（Service）、技术（Technology）维度进行供应商考核，持续推进既有产品和新产品领域的供应商考评和引入工作，积极拓展供应商资源，完善海内外布局，引入多元供应商参与公司供应链体系。在提升产能保障能力的同时，增强了公司在采购环节的议价能力，有效降低了采购成本。

（2）公司结合市场需求与自身业务发展规划，提前与代工厂等合作方开展产能扩充规划工作，通过强化数字化运营能力、推进精细化运营，以满足公司快速的规模扩张需求以及应对市场景气度的多变性。

（3）公司首发上市募集资金净额 12.46 亿元。报告期内，公司“总部基地及前沿技术研发项目”已结项，工程主体已经建设完成，公司已经取得竣工报告，且公司在该项目实施中严格遵循募集资金规定，优化资源配置及进行现金管理，实现了成本控制与资金增值。“基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目”尚在持续进行中。项目实施过程中，公司严格控制成本，合理优化资源配置，通过技术创新与工艺改进，成功实现了各类基于存储芯片的衍生芯片的产业化生产，部分产品已实现量产并推向市场，受到客户的广泛认可，进一步助力“存储+”战略的实施。

四、创新激励机制和培养体系双驱动，人才强企战略持续推进

1、全方位激励体系激发组织活力

截至 2025 年 6 月，公司员工总数持续增长，较年初员工总数增加近 10%，人才结构持续优化。新增人员分布于芯片设计、工艺研发、测试验证、市场拓展及运营管理等多个关键岗位，尤其研发团队规模进一步扩大，新增人员为公司技术创新与产品升级注入了新鲜血液，进一步强化了公司在存储芯片及“存储+”领域的技术研发实力。

公司着力完善绩效奖励制度，建立了更加科学合理的绩效考核指标体系。上半年已完成对绩效考核指标的全面梳理与优化，突出业绩导向。通过明确各岗位

关键绩效指标（KPI），将员工绩效与公司整体业绩紧密挂钩，对表现优秀的员工给予及时、丰厚的奖励，营造了积极向上、奋勇争先的工作氛围，有效激发员工工作热情与创造力。

公司持续关注市场变化与行业薪酬水平，年中对于薪酬结构进行优化调整。上半年研发人员平均薪酬 35.29 万元，凸显了公司对研发人员的重视和激励，确保公司在行业内具备强劲的薪酬竞争力，有效吸引和留住半导体领域优秀人才。

公司积极推进股权激励计划，2025 年上半年，在过往激励基础上，进一步扩大激励范围，各期激励计划的激励对象覆盖率已达全体在职员工的 80%以上，力求将更多员工利益与公司长远发展紧密捆绑，有效激发了员工的主观能动性和创造性，增强员工对公司的归属感与忠诚度。

2、构建立体化培养生态，与校企合作共筑人才高地

公司根据业务及研发实际需求，积极打造人才发展体系，围绕三大课程体系（基础培训、管理培训、技术培训）针对不同职能不同层级员工开展培训，2025 年上年度完成培训 31 场次，课程总时长 99 小时，其中技术培训 19 场，管理培训 8 场。覆盖新员工入职、专业技能提升、通用能力拓展、管理能力进阶等多个维度，培训内容涵盖半导体前沿技术、先进工艺制程、项目管理实战、市场营销策略等，有效提升员工专业素养与综合能力。例如，技术培训中尤其加强对设计质量的强调，今年新开展设计质量提升系列课程，从基础质量意识、芯片设计方法、失败和成功经验剖析这三个方面进行分享，如《行业质量标准和认证体系》、《芯片质量成本分析》、《芯片可靠性测试方法》、《面向 DFT 的芯片设计方法》等。2025 年继续加强对管理人员的赋能，从自我管理到团队管理两方面提升，开展课程如《普冉员工的高效习惯》、《导师培训》、《非人力资源的人力资源讲座》、《面试技巧》、《绩效管理介绍及面谈辅导》等课程。

公司在 2024 年首次和名校合作进行研究生的校企联合培养基础上，今年上半年积极尝试扩大校企合作规模，与高校建立更为紧密的长期稳定合作关系，共同开展人才培养、技术研发及成果转化等工作，持续推进产学研深度融合，为公司培养高学历、高技能的复合型人才。

五、透明沟通赋能价值传递，多元互动提升市场认同

报告期内，公司秉持与投资者保持紧密沟通、增强公司透明度的理念，积极开展多元化举措，全方位推动与投资者的互动交流，进一步提升公司在资本市场的形象与影响力。

1、定期报告深度交流，高频互动强化机构信任

公司围绕定期报告积极组织交流活动，2025 年一季报披露后，筹备了线上业绩说明会，定向与机构投资人进行深入交流，对报告中的关键财务数据、业务进展、市场策略等内容进行详细解读，并实时解答投资者提出的疑问。同时，公司参与上证路演中心平台 2024 年度创业板芯片设计环节行业集体业绩说明会，与公众进行充分、透明的互动交流，针对投资者关注的存储芯片市场趋势、公司“存储+”等战略推进情况，给予了详实、专业的回复，有效加深与个人投资者对于公司运营表现的理解。

报告期内，公司保持较高频次的机构交流，机构类型覆盖保险公司、基金公司、海外机构、证券研究所、私募机构等。上半年累计接待 111 家机构投资人调研，持续增强了机构投资人与公司之间的认知与信任。

2、创新沟通渠道矩阵建设，可视化呈现提升信息触达效率

公司在保留电话、邮箱、e 互动等传统沟通方式的基础上，充分发挥新兴渠道优势。公司官网设置投资者关系板块，包含股价信息，近期披露公告、投资者问答陈列、投资者热线及邮箱等，有效打造了投资人获取公司官方信息的权威窗口。同时，公司高度重视上证 e 互动平台的运营，对投资者提出的问题保持 100% 的回复率，确保投资者关切得到及时回应。此外，公司官方微信公众号定期发布公司新闻、新产品推出等图文内容，也同步于东方财富、同花顺等相关投资者平台网站发布，以多元化的形式向投资者传递公司价值。

为了提高定期报告的可读性和实用性，公司采用多种创新形式，如定期报告披露后，及时在公众号发布解读长图文，以通俗易懂的语言、直观的数据表，提炼报告要点，帮助公司快速把握季度经营状况。此外，公司上半年积极参与上证路演中心“科创 3 分钟”高管开放麦主题活动，创新性地以短视频集成可视化年报、董事长致辞、业绩亮点、投资者回报举措等市场关心内容，配套可视化年报

长图文，帮助投资者更加直观地获得公司的讯息和动向，提高公司的可看性、可及性、可投性，持续提高公司投资者互动质量。

六、合规与效率并重，内控体系升级强化风险管理与治理效能

2025 年上半年，普冉股份聚焦战略目标与合规要求，持续优化内部控制体系，强化监督与风险管理，为稳健运营筑牢基础。

公司及时对公司内部管理制度进行更新与修订，以确保公司规范运作，维护投资者的合法权益，并安排董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员积极参加由上海证券交易所等监管机构举办的培训活动。通过这些培训，确保公司内部的关键人员能够及时掌握最新的法律法规，提升其履行职责的能力，进而推动公司整体治理水平的提升。此外，公司还持续关注资本市场的最新规则和监管趋势，并及时将相关信息传达给董事会及管理层，以确保公司与监管政策保持高度一致，积极配合资本市场的监管机制。

监事会严格履行监督职能，通过审阅财报、参与会议、实地调研等方式，监督董事及高管履职，重点关注战略规划、重大投资与关联交易审批，确保合规运作。

公司及时向独立董事通报经营状况及重大事件，同时提交相关文件，为独立董事履行职责创造便利条件，充分保障其知情权，增强独立董事对公司运营的监督效能。

内部审计部门独立运作，按计划审计财务收支、内控执行与重大项目，审查财务数据真实性与费用合规性，评估内控制度执行并督促整改，开展重大项目专项审计保障实施。

围绕基础制度，公司不断优化流程机制，提升办公效率。合同管理在信息化系统中实现全流程管理，并提供符合内控要求及出口管制等相关合规要求的模板；项目管理进一步明确各阶段职责，强化进度、质量与成本监控。公司于 2024 年在公司 OA 系统中创新开设 DCC 文件查询清单，旨在进一步强化文件管理与信息流通的便捷性、高效性，是公司推进办公流程数字化、精细化管理的重要举措。2025 年上半年，公司引入飞书办公系统，通过其高效沟通协作功能、强大的项目管理工具、智能的知识管理体系等多方面来提高工作效率。

综上，上半年公司内控体系完善成效显著。未来将持续优化治理结构，强化审计与监督，为战略目标实现提供保障。

综上所述，报告期内，公司严格执行此前制定的行动方案，并取得了一定进展。2025 年下半年，公司仍将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。未来，公司将进一步提升经营管理水平，专注主业，强化核心竞争力，持续优化盈利能力，保持高质量稳健成长。同时，公司也将一如既往地关注资本市场动向，结合业务现状、未来发展规划和行业发展趋势，为投资者带来长期的价值投资回报。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日